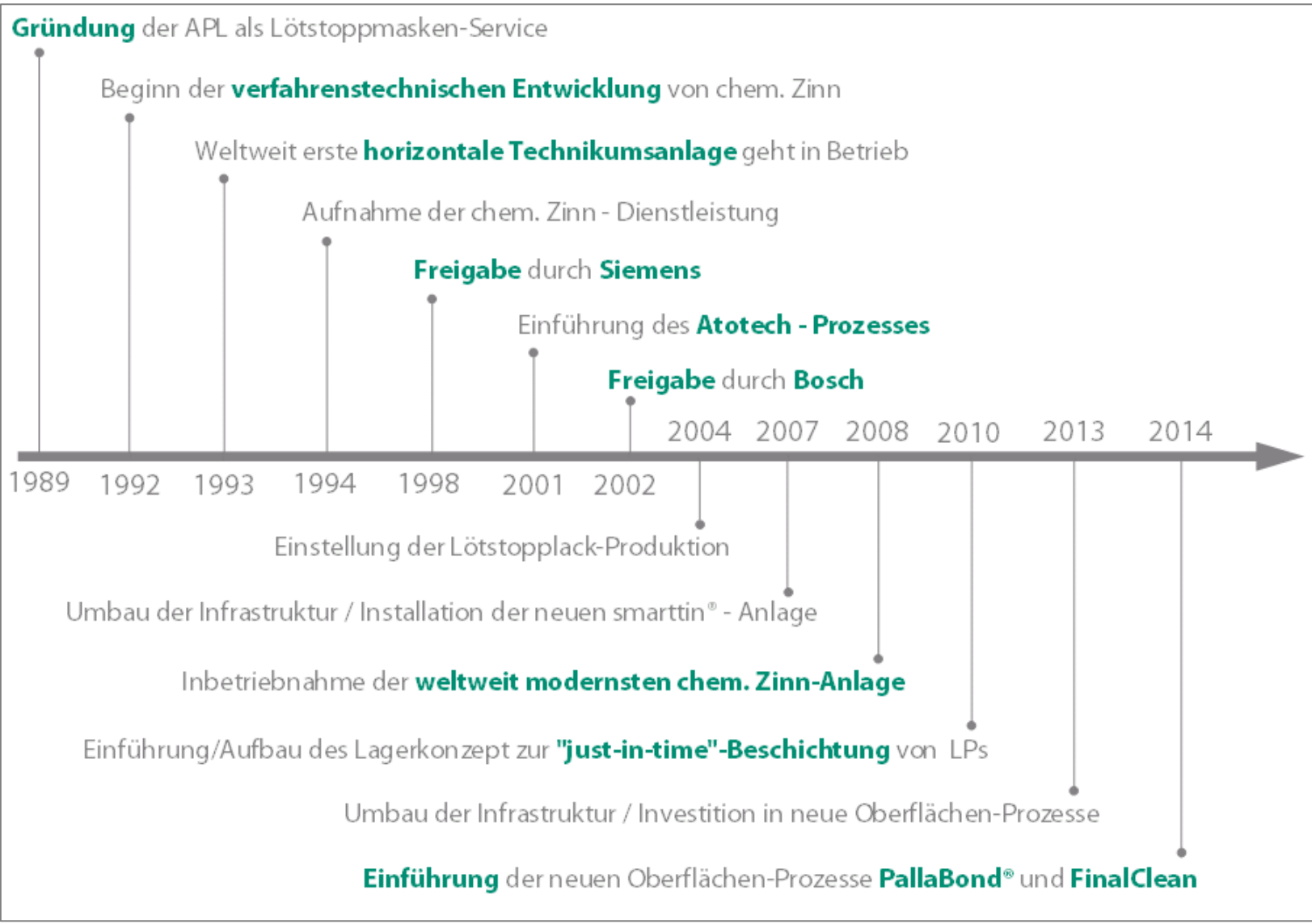




# 25 Jahre APL Oberflächentechnik Jubiläumskonferenz Lörrach | 25.09.2014





• **Neue Dienstleistungen ab Q3/2014**



EPAG

**Palladium / Gold**

High End – Anwendungen  
Spezialtechniken  
Au & Cu - Bonden



iSn

**Immersion tin**

Mid/High End –  
Anwendungen  
Lötanwendungen  
Einpresstechnik



**FinalClean**

Reinigen von ENIG /  
ENEPIG - Leiterplatten



## Das heutige Programm

- 09.30 Uhr **Begrüßung und Eröffnung der Jubiläumskonferenz**  
Walter Tastl (APL Oberflächentechnik GmbH)
- 09.45 Uhr **More than Moore - die Trends 2020 der Aufbau- und Verbindungstechnik**  
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Wilde (Albert-Ludwigs-Universität  
Freiburg, Institut für Mikrosystemtechnik - IMTEK)
- 10.30 Uhr **Neue Innovationsmöglichkeiten in der Elektronik durch PallaBond®**  
Maren Bruder (Atotech Deutschland GmbH)
- 11.15 Uhr *Kaffeepause*
- 11.30 Uhr **Beschaffung von Leiterplatten aus Fernost bei Mindermengenbedarf**  
Lutz Bruderreck (TechnoLab GmbH)
- 12.30 Uhr *Mittagessen*
- 13.30 Uhr **Andere Wege gehen**  
Matthias Löffler (Icape Group)
- 14.15 Uhr **Aktuelle Trends der Verbindungstechnik: Vom Cu-Drahtbond zum Embedding**  
Andreas Ostmann (Gruppenleiter Embedding & Substrate Technologies Fraunhofer IZM)
- 15.00 Uhr *Kaffeepause*
- 15.15 Uhr **Mainboards mit Sn-Oberfläche made in Germany**  
Eugen Kastner (Fujitsu Augsburg)
- 16.00 Uhr **Schlusswort & Beendung der Veranstaltung**



**APL wünscht allen  
Teilnehmern einen  
spannenden und  
informativen  
Konferenztag !**